

SiC ウェーハ研削盤

Model R631BM

**SEMICON[®]
JAPAN**



ジェイテクトマシンシステム

出展のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社はこのたび「SEMICON JAPAN 2023」へ出展いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、SiCウェーハ研削盤R631BMの実機展示を行います。

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2023年11月吉日
株式会社ジェイテクトマシンシステム
代表取締役社長 宮藤 賢士

開催概要・出展位置

会期:2023年12月13日(水)~15日(金)

開催時間:10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト

出展位置:**東2ホール 2319**

共同出展:株式会社ジェイテクト、株式会社ジェイテクトグラインディングツール

JTEKT 株式会社ジェイテクトマシンシステム